

報道関係者各位

2011年6月8日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel Core i7/i5/i3 用に最適化されたDDR3 デュアルチャンネルメモリー
容量 8GB(4GB×2 枚セット)、CL=9-10-9-27、DDR3-1866MHz
XMP対応、AirFlow Pro接続コネクタ搭載、Airflowファン同梱
最上位DOMINATOR GTシリーズ CMT8GX3M2A1866C9**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel Core i7/i5/i3 のプラットフォームに最適化された DDR3 メモリー、容量 8GB(4GB×2 枚)最上位 DOMINATOR GT シリーズ CMT8GX3M2A1866C9 を 2011 年 6 月 11 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

DOMINATOR GT シリーズ CMT8GX3M2A1866C9 は、PC3-15000(DDR3-1866MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリーです。デュアルチャンネル動作に最適な 4GB メモリーの 2 枚セットです。Intel Core i7/i5/i3 のプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。冷却用の AirFlow ファンを同梱したハイエンドモデルです。

DOMINATOR GT モジュールは、厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性を持ちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。



放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術 DHX (Dual-Path Heat Exchange) を搭載しています。DHX は伝導と対流という 2 つの熱消散経路で従来では難しかったプリント板(PCB)内の冷却を実現しています。

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去します。

Intel が独自に仕様を策定した規格、XMP (Extreme Memory Profile) に対応しています。SPD を拡張し自動的にメモリーのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

メモリーの基盤上に、AirFlow Pro※接続用のコネクタを搭載しています。AirFlow Pro は、リアルタイムでメモリーの温度と使用率をモニタリングすることができます。温度や使用率は本体の LED により、一目で確認することができます。

型番は CMT8GX3M2A1866C9。容量は 4GB × 2 枚の合計 8GB。メモリー規格は PC3-15000(DDR3-1866MHz)、デスクトップ用 240Pin DIMM メモリー。転送クロックは 1866MHz。CAS レイテンシは CL=9-10-9-27。DHX ヒートシンク搭載。サイズは 53 × 133mm。AirFlow ファンを同梱しています。永久保証が提供されます。

※AirFlow Pro は付属しません。

【CMT8GX3M2A1866C9 製品特徴】

・Intel Core i7/i5/i3 用に最適化されたメモリー

DOMINATOR GT シリーズ CMT8GX3M2A1866C9 は、PC3-15000(DDR3-1866MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリーです。デュアルチャンネル動作に最適な 4GB メモリーの 2 枚セットです。Intel Core i7/i5/i3 のプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。

・最適なチップのみを採用した DOMINATOR GT シリーズ

厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。

・放熱を最大化する独自の冷却技術 DHX

DHX(Dual-Path Heat Exchange)は、放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術です。メモリーモジュールから熱を効果的に除去するために伝導と対流という 2 つの熱消散経路を利用しています。

・プリント板も冷却する優れた伝導熱消散

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去します。

・オーバークロック機能 XMP 対応

XMP(Extreme Memory Profile)は、Intel が独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリーのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

・AirFlow ファン同梱

メモリ上部に搭載する特殊なメモリ冷却システム Airflow ファンを同梱しています。Airflow ファンは、60mm 制御ファンを 2 基搭載し、メモリーサブシステムに衝突気流を発生させ冷却いたします。ほとんどのマザーボードに簡単に取り付けることができます。

・AirFlow Pro 接続コネクタ搭載

メモリーの基盤上に、AirFlow Pro 接続用のコネクタを搭載しています。AirFlow Pro は、リアルタイムでメモリーの温度と使用率をモニタリングすることができます。温度や使用率は本体の LED により、一目で確認することができます。<http://www.links.co.jp/items/corsair-others/cmxaipro.html>

※AirFlow Pro は付属しません。

・安心の永久保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は永久保証です。

【CMT8GX3M2A1866C9 製品詳細】

型番	CMT8GX3M2A1866C9
容量	8GB(4GB×2枚セット)
規格	PC3-15000(DDR3-1866MHz)
種類	240Pin DDR3-SDRAM Unbuffered DIMM
転送クロック	1866MHz
サイズ	基板サイズ:39×133mm 全体サイズ:53×133mm
レイテンシ	9-10-9-27
XMP	対応
定格電圧	1.50V
デュアルチャンネル	対応
RoHS	適合
その他	Airflow ファン 同梱
ヒートシンク	DHX 搭載
保証	永久保証

【CMT8GX3M2A1866C9 発売詳細】

◆製品名称

CMT8GX3M2A1866C9

◆発売日

2011年6月11日

◆店頭予想売価

19,800円前後(OPEN)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cmt8gx3m2a1866c9.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1110>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>